

HM26产品手册 超低损耗粘结片



Features and benefits 特性与优势

- HM26粘结片是一种无增强材料的热固型碳氢树脂与陶瓷复合材料，拥有超低介质损耗和高流动特性。
- 适用于77GHz毫米波等对插入损耗敏感的应用场景。
- 无编织增强材料带来的网格效应，且流动性更强，实现了薄粘结层，厚度目前有2mil,4mil厚度可选。
- 兼容多种基材，可以与PTFE、环氧树脂、PPO树脂、碳氢树脂和LCP等材料进行粘合。
- 不高于210°C的热压合温度使得HM26粘结片可以满足大多数多层线路板加工工艺，而经过热压固化后的材料Tg高达260°C以上。
- 固化后的材料仍有韧性，可在一定程度内弯折使用。

Areas of application 典型应用

- 毫米波天线
- 射频电路
- 高速数字电路

Standard size 标准尺寸

- 12" X 18" (305 X 457 mm)
- 24" X 18" (610 X 457 mm)

序号 No	性能 Property	测试方法 Test Method	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Value
1	厚度 Thickness	—	—	mil	2.0
2	介电常数 10 GHz Permittivity at 10 GHZ	IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	2.65 ± 0.05
3	损耗角正切值 10 GHz Loss Tangent at 10 GHZ	IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	0.0020
4	热导率 Thermal Conductivity	ASTM D5470	70°C	W/(m·K)	0.34
5	表面电阻率 Surface Resistivity	IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ	10 ¹⁰
6	体积电阻率 Volume Resistivity	IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ·cm	10 ¹¹
7	吸水率 Moisture Absorption	IPC TM-650 2.5.6.1	D-48/50	%	0.06
8	密度 Density	ASTM D792 Method A	23°C	g/cm ³	1.2
9	耐燃性 Flammability	UL94 Vertical Burn	—	—	V-0

说明1: 典型值表示通常厚度情况下的多次测量不同批次产品性能指标的平均数值。如果对参数有特殊需求或疑问, 请联系湍流电子公司。

Remark1: Typical value represent an average value from a population of tested material and on the most common thickness. For any specific requirement or question, please contact Tuanliu Electric Co.